

北京君正集成电路股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，本公司就 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2020 年度发行股份购买资产募集配套资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938 号）核准，公司 2020 年度发行股份购买资产募集配套资金不超过 150,000.00 万元。本次募集配套资金发行人民币普通股（A 股）18,181,818 股，发行价格为人民币 82.50 元/股，募集资金总额为人民币 1,499,999,985.00 元。截至 2020 年 8 月 28 日，公司实际收到募集资金人民币 1,499,999,985.00 元。

上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了[2020]京会兴验字第 01000005 号《验资报告》，公司对募集资金实行专户存储。

2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京君正集成电路股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3097 号）核准，公司 2021 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 12,592,518 股，发行价

格为每股人民币 103.77 元。截至 2021 年 10 月 29 日，公司募集资金总额为人民币 1,306,725,592.86 元，扣除证券承销费及保荐费用（含税）后，实际收到募集资金 1,282,076,091.37 元。募集资金总额扣除全部不含税发行费用 26,039,208.28 元后的净额为 1,280,686,384.58 元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“XYZH/2021BJAB11063”号《北京君正集成电路股份有限公司 2021 年 10 月 29 日验资报告》，公司对募集资金实行专户存储。

（二）本报告期募集资金使用情况及结余情况

1、2020 年度发行股份购买资产募集配套资金

截至本报告期末，公司已累计使用募集资金投入募投项目金额为 133,326.24 万元，累计银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为 2,686.82 万元，其中本报告期实际使用募集资金投入募投项目金额为 985.60 万元，本报告期银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为 75.31 万元，截至本报告期末，募集资金账户余额合计为 19,360.59 万元。

募集资金存放与投入情况具体如下：

项目	金额（万元）
期初募集资金账户余额	20,270.89
加：利息收入和现金管理收益扣除手续费净额	75.31
减：募投项目投入	985.60
期末募集资金账户余额	19,360.59

2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金

截至本报告期末，公司累计使用募集资金投入募投项目金额为 66,306.86 万元，累计支付相关发行费用为 280.19 万元（不含证券承销费及保荐费用），累计银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为 6,927.61 万元，其中本报告期实际使用募集资金投入募投项目金额为 1,391.40 万元，本报告期银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为 339.95 万元，截至本报告期末，募集资金账户余额合计为 68,548.14 万元。

募集资金存放与投入情况具体如下：

项目	金额（万元）
----	--------

期初募集资金账户余额	69,599.58
加：利息收入和现金管理收益扣除手续费净额	339.95
减：募投项目投入	1,391.40
期末募集资金账户余额	68,548.14

本报告中除特别说明外，所有数值保留两位小数，部分合计数与其分项加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司制订了《北京君正集成电路股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用；同时，为提高闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，结合公司募集资金实际使用情况，公司对部分闲置募集资金在一定额度内进行了现金管理，投资于银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。

根据相关要求，公司与华夏银行股份有限公司北京分行、国泰君安证券股份有限公司、中德证券有限责任公司于2020年8月28日签订了募集资金三方监管协议；公司、北京矽成半导体有限公司与华夏银行股份有限公司北京分行、国泰君安证券股份有限公司、中德证券有限责任公司于2020年10月23日签订了募集资金四方监管协议；公司、芯成半导体（上海）有限公司与南京银行股份有限公司上海分行、国泰君安证券股份有限公司、中德证券有限责任公司于2020年11月2日签订了募集资金四方监管协议；公司与华夏银行股份有限公司天津分行、国泰君安证券股份有限公司于2021年11月23日签订了募集资金三方监管协议；公司、合肥君正科技有限公司与华夏银行股份有限公司北京分行、国泰君安证券股份有限公司于2021年11月24日签订了募集资金四方监管协议；公司、合肥君正科技有限公司与华夏银行股份有限公司合肥分行、国泰君安证券股份有限公司于2023年12月22日签订了募集资金四方监管协议；公司、芯成半导体（上海）有限公司与中国银行股份有限公司合肥分行、国泰君安证券股份有限公司于2025

年 8 月 15 日签订了募集资金四方监管协议；公司、深圳君正时代集成电路有限公司与华夏银行股份有限公司北京城市副中心分行、国泰海通证券股份有限公司于 2026 年 6 月 12 日签订了募集资金四方监管协议。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定的要求，协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存储情况

1、截至本报告期末，公司 2020 年度发行股份购买资产募集配套资金专项账户情况如下：

单位：元

募集资金存储银行名称	账号	账户余额	存储方式
华夏银行	10276000001067386	699,902.85	活期
小计		699,902.85	
华夏银行	10276000001069532	8,438,126.09	活期
	10276000001295813	24,000,000.00	定期存款
	10276000001296248	110,000,000.00	结构性存款
小计		142,438,126.09	
南京银行	0301240000004337	50,467,914.51	活期
小计		50,467,914.51	
合计		193,605,943.45	

2、截至本报告期末，公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金专项账户情况如下：

单位：元

募集资金存储银行名称	账号	账户余额	存储方式
华夏银行	12350000002883198	25,550,282.24	活期
	12350000004797488	20,000,000.00	结构性存款
	12350000004772418	90,000,000.00	结构性存款
小计		135,550,282.24	
华夏银行	10291000002846531	50,000,694.44	活期

小计		50,000,694.44	
华夏银行	10276000001112728	36,121,922.15	活期
	10276000001292539	110,000,000.00	结构性存款
	10276000001296645	80,000,000.00	结构性存款
	10276000001296306	20,000,000.00	定期存款
小计		246,121,922.15	
中国银行	185782631570	18,807,306.78	活期
	188786435365	110,000,000.00	结构性存款
	187286435372	110,000,000.00	结构性存款
小计		238,807,306.78	
华夏银行	14760000000115843	15,001,177.63	活期
小计		15,001,177.63	
合计		685,481,383.24	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、2020 年度发行股份购买资产募集配套资金使用情况

截至本报告期末，公司累计使用 2020 年度发行股份购买资产募集配套资金投入募投项目金额 133,326.24 万元，2020 年发行股份购买资产募集配套资金使用情况对照表详见本报告附表一。

2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况

截至本报告期末，公司累计使用 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投入募投项目金额 66,306.86 万元，2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表二。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、结合公司业务发展的需要，为优化资源配置，根据内部的资金使用安排，2023 年，公司计划使用自有资金由全资子公司北京矽成半导体有限公司向矽恩微电子（厦门）有限公司（已更名为“络明芯微电子（厦门）有限公司”）增资人民币两亿元。增资后，络明芯微电子（厦门）有限公司将有充裕的自有资金进行技术和产品的研发及日常运营，包括“车载 LED 照明系列芯片的研发与产业化项目”在内的研发项目均可以自有资金继

续推进。同时，为加大对核心技术的研发，不断加强公司计算芯片的产品竞争力，提高公司综合竞争能力，经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议以及2022年年度股东大会审议通过，公司将“车载LED照明系列芯片的研发与产业化项目”变更为“合肥君正研发中心项目”。

2、“车载ISP系列芯片的研发与产业化项目”实施以来，公司进行了相关车规体系建设工作，包括车规ISP芯片关键性技术的评估和预研，以及部分核心IP的研发。但车规芯片从研发到产业化所需时间通常较长，车规ISP芯片完成设计和产业化仍需一定时间。随着人工智能技术的不断发展，AI芯片的算力性能不断提升，面向各类应用的AI大模型也不断涌现并快速迭代与完善，AI模型和高性能计算对DRAM的带宽需求以每年倍数级的速度增长，传统DRAM已无法满足此等速度要求，而3D DRAM通过垂直堆叠、垂直互联等技术可大幅提升DRAM的存储密度和数据带宽，从而可以有效满足AI芯片与高性能计算芯片对DRAM高带宽、大容量的需求。因此，经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议以及2024年年度股东大会审议通过，公司将“车载ISP系列芯片的研发与产业化项目”变更为“3D DRAM芯片的研发与产业化项目”。

截至本报告期末，公司变更募集资金投资项目的情况表详见本报告附表三。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表一：2020年度发行股份购买资产募集配套资金使用情况对照表

附表二：2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附表三：变更募集资金投资项目情况表

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十八日

附表一：

2020年度发行股份购买资产募集配套资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				150,000.00	本报告期投入募集资金总额					985.60
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00						
累计变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额					133,326.24
累计变更用途的募集资金总额比例				0%						
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投 入金额	截至报告期末 累计投入金额 (2)	截至报告期 末投资进度 (%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否发 生重大变化
承诺投资项目										
支付公司重大资产重 组部分现金对价	否	115,949.00	115,949.00	0.00	115,949.00	100.00	不适用		不适用	否
面向智能汽车和智慧 城市的网络芯片研发 项目	否	17,900.00	17,900.00	365.34	5,186.90	28.98	2029/1/1		不适用	否
面向智能汽车的新一 代高速存储芯片研发 项目	否	16,151.00	16,151.00	620.26	12,190.33	75.48	2030/6/30		不适用	否
承诺投资项目小计		150,000.00	150,000.00	985.60	133,326.24					
超募资金投向										
无										

超募资金投向小计										
合计		150,000.00	150,000.00	985.60	133,326.24					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	1、“支付公司重大资产重组部分现金对价项目”募集资金用于支付购买北京矽成 59.99%的股权和上海承裕 100%的财产份额的部分现金对价，无法单独核算经济效益。 2、“面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目”自 2020 年启动以来，全球政治经济环境等发生了较多变化，影响了公司车载网络芯片项目研发和推广进度，同时，随着汽车智能化的不断发展，智能汽车对网络芯片的需求也在不断发生变化，相关方案的复杂度较高，方案导入所需要的时间也较长，客户方案落地较慢。鉴于车载网络芯片在设计开发、市场推广、客户产品导入等方面往往需要较长时间的行业特点，以及项目实施过程中客观因素对实施进度的影响，经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，“面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目”预定可使用日期由 2025 年 1 月 1 日调整为 2029 年 1 月 1 日，报告期内尚处于建设阶段。 3、“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”自 2020 年启动以来，全球政治环境、经济形势、市场环境等情况发生较大变化，公司车载存储芯片的研发、验证及推广等工作进度均受到不同程度的影响。但随着汽车智能化的不断升级，汽车智能驾驶相关技术不断发展，车规市场对存储芯片的需求也在不断增长，从而给公司存储芯片产品带来更大的成长空间和较好的预期效益。鉴于项目实施内容和可行性均未发生改变，考虑到车载存储芯片在设计开发、市场推广、客户产品导入等方面往往需要较长时间，以及项目实施过程中客观因素对实施进度可能造成的影响，经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”预定可使用日期由 2025 年 6 月 30 日调整为 2030 年 6 月 30 日，报告期内尚处于建设阶段。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、2020年12月14日，经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京君正集成电路股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（[2020]京会兴专字第01000022号），公司以募集资金80,000,000.00元置换预先已使用自筹资金支付的公司重大资产重组部分现金对价，以募集资金6,135,503.45元置换预先已投入募集资金投资项目“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”的自筹资金，以募集资金6,934,137.16元置换预先已投入“面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目”的自筹资金。 2、2025年12月10日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目部分款项的议案》，根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定，公司以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目部分款项，其中“面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目”置换金额为225.67万元，“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”置换金额为851.27万元。上述募集资金置换期间为2025年6月15日至2025年11月01日。 3、2026年3月26日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目部分款项的议案》，根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定，公司以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目部分款项，其中“面向智能汽车和智慧城市的网络芯片研发项目”置换金额为262.04万元，“面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目”置换金额为652.78万元。上述募集资金置换期间为2025年11月02日至2026年3月20日。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	2025年12月10日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用2020年度向特定对象发行股票募集资金不超过20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，投资产品期限不超过12个月，有效期为自第六届董事会第八次会议审议通过之日起一年内。在上述额度内，资金可滚动使用。公司独立财务顾问出具了明确无异议的核查意见。 本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理，对应收益情况参见本报告期募集资金使用情况及结余情况内容。截至本报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币13,400万元。其中，1、投资份额2,400万元，签约方为华夏银行，产品名称为定期存款人，起息日为2026年6月12日，到期日为2026年12月12日；2、投资份额11,000万元，签约方为华夏银行，产品名称为人民币单位结构性存款DWJCBJ26184，起息日为2026年6月16日，到期日为2026年12月18日。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司尚未使用的募集资金部分存放于募集资金专户，部分进行现金管理。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

公司负责人：刘强

主管会计工作的负责人：叶飞

会计机构负责人：李莉

附表二：

2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				130,672.56	本报告期投入募集资金总额						1,391.40
报告期内变更用途的募集资金总额				22,064.60							
累计变更用途的募集资金总额				33,019.65	已累计投入募集资金总额						66,306.86
累计变更用途的募集资金总额比例				25.78%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至报告期末累计投入金额(2)	截至报告期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
嵌入式 MPU 系列芯片的研发与产业化项目	否	21,155.30	21,155.30	0.00	4,364.86	20.63	2029/9/1	6,157.03	不适用	否	
智能视频系列芯片的研发与产业化项目	否	36,239.16	36,239.16	701.78	14,201.84	39.19	2029/9/1	28,294.28	不适用	否	
车载 LED 照明系列芯片的研发与产业化项目	是	17,542.44	6,587.39	0.00	6,576.90	99.84	不适用		不适用	否	
车载 ISP 系列芯片的研发与产业化项目	是	23,735.66	1,671.06	0.00	1,671.06	100.00	不适用		不适用	否	
补充流动资金	否	29,254.83	29,254.83	0.00	29,355.36	100.34	不适用		不适用	否	
合肥君正研发中心项目	否	0.00	11,332.64	677.04	10,124.28	89.34	2026/5/19		不适用	否	
3D DRAM 芯片的研发与产业化项目	否	0.00	23,560.28	12.57	12.57	0.05	2030/5/12				

承诺投资项目小计		127,927.39	129,800.66	1,391.40	66,306.86			34,451.31		
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合计		127,927.39	129,800.66	1,391.40	66,306.86			34,451.31		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	1、“嵌入式 MPU 系列芯片的研发与产业化项目”启动后，2021 年底开始消费类电子产品市场环境发生了较大变化，导致客户需求减缓，新项目计划延迟。为确保募投项目的安全性，审慎使用募集资金，公司综合考虑市场各因素的变化情况，放缓了募投项目的实施进度。2023 年，随着市场需求的复苏和产业链的库存去化，市场呈良性发展趋势。为及时抓住市场发展机遇，不断扩大公司的市场份额，把握长期发展机会，公司需要针对智能物联网的发展趋势和产品需求变化继续推出更高性能和性价比的嵌入式 MPU 芯片产品。同时，考虑到集成电路市场周期性波动可能会对项目实施带来的影响，经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，“嵌入式 MPU 系列芯片的研发与产业化项目”预定可使用日期由 2024 年 9 月 1 日调整为 2027 年 9 月 1 日。为及时抓住 AI 发展下不断涌现的市场发展机遇，丰富公司嵌入式计算芯片的系列化布局，形成覆盖端侧高、中、低端算力的产品矩阵，全面覆盖 AIoT 领域对芯片 AI 性能有不同需求的智能硬件产品市场，扩大公司的市场份额，把握长期发展机会，为公司带来更多的经济效益，经公司第六届董事会第十次会议及 2025 年年度股东会审议通过，公司将“嵌入式 MPU 系列芯片的研发与产业化项目”的产品品类中增加 AI MCU，在不改变项目名称与核心方向的前提下，对嵌入式 MPU 芯片产品进行拓展延伸，同时，由于公司 AI MCU 由深圳君正时代集成电路有限公司（以下简称“深圳君正”）牵头组织实施，该项目的实施地点同时增加深圳君正。鉴于调整后的募集资金投资项目增加了实施内容，同时，为持续加强公司产品的市场竞争力，公司需对嵌入式 MPU 产品进行不断的升级迭代，根据市场发展情况推出更多款符合市场需求的产品，公司同时将原计划完成时间由 2027 年 9 月 1 日调整为 2029 年 9 月 1 日。报告期内该项目尚处于建设阶段。 2、“智能视频系列芯片的研发与产业化项目”启动后，2021 年底开始消费类电子产品市场环境发生了较大变化，客户需求减缓，新项目计划延迟。为确保募投项目的安全性，审慎使用募集资金，公司综合考虑市场各因素的变化情况，适当放缓了募投项目的实施进度。2023 年，随着市场需求的复苏和产业链库存压力的下降，市场呈良性发展趋势。为及时抓住市场发展机遇，不断扩大公司的市场份额，把握长期发展机会，公司需要针对智能视觉 IoT 领域，尤其安防监控领域的发展趋势和产品需求变化继续推出更具竞争力的芯片产品。同时，考虑到集成电路市场周期性波动可能会对项目实施带来的影响，经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，“智能视频系列芯片的研发与产业化项目”预定可使用日期由 2024 年 9 月 1 日调整为 2027 年 9 月 1 日。近几年来，在 AI 技术快速发展的情况下，智能视觉技术在更多领域得到应用与发展，泛视觉市场也呈现了更多的发展机会，一些泛视觉领域的客户，如 AI 眼镜、运动耳机、工业检测、医疗检测等市场的客户，采用公司 IPC 芯片进行了产品研发。为更好地满足泛									

	视觉领域的产品需求，使公司产品在智能穿戴、智能检测等更多领域有更强的产品竞争力，公司进行了专门面向泛视觉领域的芯片产品研发。经公司第六届董事会第十次会议及 2025 年年度股东会审议通过，公司将“智能视频系列芯片的研发与产业化项目”的产品中，在面向安防监控领域的 IPC 芯片和 NVR/DVR 芯片产品之外，增加面向泛视觉领域的产品品类，面向安防领域和泛视觉领域的产品均属于智能视频芯片产品系列。鉴于调整后的募集资金投资项目增加了实施内容，同时，为持续加强公司产品的市场竞争力，公司需对智能视觉芯片产品进行不断的升级迭代，根据市场变化情况，推出更多款符合市场需求及更高算力的产品，因此，公司同时将原计划完成时间由 2027 年 9 月 1 日调整为 2029 年 9 月 1 日。报告期内该项目尚处于建设阶段。 3、经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议以及 2022 年年度股东大会审议通过，“车载 LED 照明系列芯片的研发与产业化项目”变更为“合肥君正研发中心项目”。 4、经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议以及 2024 年年度股东大会审议通过，“车载 ISP 系列芯片的研发与产业化项目”变更为“3D DRAM 芯片的研发与产业化项目”。 5、“补充流动资金项目”能有效缓解公司资金压力，有利于增强公司综合竞争力，是公司实现持续健康发展的切实保障，但无法单独核算经济效益。 6、“合肥君正研发中心项目”不直接为公司带来销售收入，无法单独核算经济效益。项目着重底层计算技术和新技术的研究，为公司芯片产品提供业界领先的关键性核心技术，有助于不断提高公司计算芯片的产品竞争力，从而有助于提高公司产品的市场销售，对公司长远发展和未来盈利能力有着重要的支撑作用。 7、“3D DRAM 芯片的研发与产业化项目”预定可使用日期为 2030 年 5 月 12 日，报告期内尚处于建设阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、2021 年 12 月 3 日，经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京君正集成电路股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2021BJAB11087），公司以募集资金 154.55 万元置换预先已投入募集资金投资项目“嵌入式 MPU 系列芯片的研发与产业化项目”的自筹资金，以募集资金 136.98 万元置换预先已投入“智能视频系列芯片的研发与产业化项目”的自筹资金，以募集资金 279.35 万元置换预先已投入“车载 LED 照

	明系列芯片的研发与产业化项目”的自筹资金，以募集资金 14.90 万元置换预先已投入“车载 ISP 系列芯片的研发与产业化项目”的自筹资金。 2、2025 年 12 月 10 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目部分款项的议案》，根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定，公司以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目部分款项，其中“智能视频系列芯片的研发与产业化项目”置换金额为 2.34 万元，“合肥君正研发中心项目”置换金额为 1,564.59 万元。上述募集资金置换期间为 2025 年 6 月 15 日至 2025 年 11 月 01 日。 3、2026 年 3 月 26 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目部分款项的议案》，根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定，公司以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目部分款项，其中“合肥君正研发中心项目”置换金额为 29.97 万元。上述募集资金置换期间为 2025 年 11 月 02 日至 2026 年 3 月 20 日。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	2025 年 12 月 10 日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用 2021 年度向特定对象发行股票募集资金不超过 69,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，投资产品期限不超过 12 个月，有效期为自第六届董事会第八次会议审议通过之日起一年内。在上述额度内，资金可滚动使用。公司保荐机构出具了明确无异议的核查意见。 本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理，对应收益情况参见本报告期募集资金使用情况及结余情况内容。截至本报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 54,000 万元。其中，1、投资份额 2,000 万元，签约方为华夏银行，产品名称为人民币单位结构性存款 DWJCTJ26040，起息日为 2026 年 5 月 18 日，到期日为 2026 年 11 月 20 日；2、投资份额 9,000 万元，签约方为华夏银行，产品名称为人民币单位结构性存款 2610093，起息日为 2026 年 2 月 2 日，到期日为 2026 年 8 月 3 日；3、投资份额 11,000 万元，签约方为华夏银行，产品名称为人民币单位结构性存款 DWJCBJ26159，起息日为 2026 年 5 月 13 日，到期日为 2026 年 8 月 14 日；4、投资份额 8,000 万元，签约方为华夏银行，产品名称为人民币单位结构性存款 DWJCBJ26185，起息日为 2026 年 6 月 18 日，到期日为 2026 年 9 月 21 日；5、投资份额 2,000 万元，签约方为华夏银行，产品名称为定期存款，起息日为 2026 年 6 月 16 日，到期日为 2026 年 9 月 16 日；6、投资份额 11,000 万元，签约方为华夏银行，产品名称为人民币结构性存款，起息日为 2026 年 4 月 30 日，到期日为 2026 年 8 月 31 日；7、投资份额 11,000 万元，签约方为华夏银行，产品名称为人民币结构性存款，起息日为 2026 年 4 月 30 日，到期日为 2026 年 11 月 2 日。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因	2026年5月21日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“合肥君正研发中心项目”已实施完毕，为提高资金使用效率，公司对该募投项目进行结项，并将节余募集资金1,497.99万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。公司在该募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，节约了部分募集资金，使募投项目实际投资金额小于计划投资金额。该事项尚需提请公司股东会审议。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司尚未使用的募集资金部分存放于募集资金专户，部分进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

公司负责人：刘强

主管会计工作的负责人：叶飞

会计机构负责人：李莉

附表三：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至报告期末实际累计投入金额(2)	截至报告期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合肥君正研发中心项目	车载LED照明系列芯片的研发与产业化项目	11,332.64	677.04	10,124.28	89.34	2026/5/19		不适用	否
3D DRAM 芯片的研发与产业化项目	车载ISP系列芯片的研发与产业化项目	23,560.28	12.57	12.57	0.00	2030/5/12		不适用	否
合计		34,892.92	689.61	10,136.85					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、结合公司业务发展的需要，为优化资源配置，根据内部的资金使用安排，2023年，公司计划使用自有资金由全资子公司北京矽成半导体有限公司向矽恩微电子（厦门）有限公司（已更名为“络明芯微电子（厦门）有限公司”）增资人民币两亿元。增资后，络明芯微电子（厦门）有限公司将有充裕的自有资金进行技术和产品的研发及日常运营，包括“车载LED照明系列芯片的研发与产业化项目”在内的研发项目均可以自有资金继续推进。同时，为加大对核心技术的研发，不断加强公司计算芯片的产品竞争力，提高公司综合竞争能力，经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议以及2022年年度股东大会审议通过，公司将“车载LED照明系列芯片的研发与产业化项目”变更为“合肥君正研发中心项目”。公司于2023年4月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于变更募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》。 2、“车载ISP系列芯片的研发与产业化项目”实施以来，公司进行了相关车规体系建设工作，包括车规ISP芯片关键性技术的评估和预研，以及部分核心IP的研发。但车规芯片从研发到产业化所需时间通常较长，车规ISP芯片完成设计和产业化仍需一定时间。随着人工智能技术的不断发展，AI芯片的算力性能不断提升，面向各类应用的AI大模型也不断涌现并快速迭代与完善，AI模型和高性能计算对DRAM的带宽需求以每年倍数级的速度增长，传统DRAM已无法满足此等速度要求，而3D DRAM通过垂直堆叠、垂直互联等技术可大幅提升DRAM的存储密度和数据带宽，从而可以有效满足AI芯片与高性能计算芯片对DRAM高带宽、大容量的需求。因此，经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事						

	会第二次会议以及 2024 年年度股东大会审议通过，公司将“车载 ISP 系列芯片的研发与产业化项目”变更为“3D DRAM 芯片的研发与产业化项目”。公司于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分募集资金投资项目延期及变更的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、“合肥君正研发中心项目”不直接为公司带来销售收入，无法单独核算经济效益。项目着重底层计算技术和新技术的研究，为公司芯片产品提供业界领先的关键性核心技术，有助于不断提高公司计算芯片的产品竞争力，从而有助于提高公司产品的市场销售，对公司长远发展和未来盈利能力有着重要的支撑作用。 2、“3D DRAM 芯片的研发与产业化项目”预定可使用日期为 2030 年 5 月 12 日，报告期内尚处于建设阶段。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

公司负责人：刘强

主管会计工作的负责人：叶飞

会计机构负责人：李莉